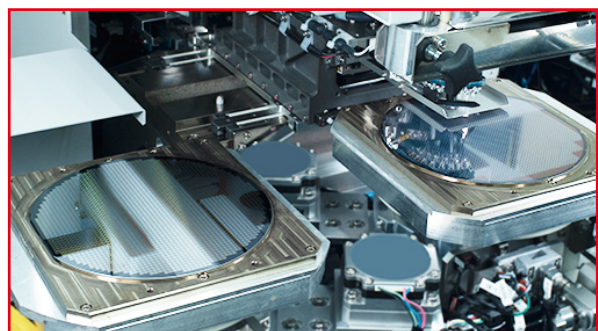
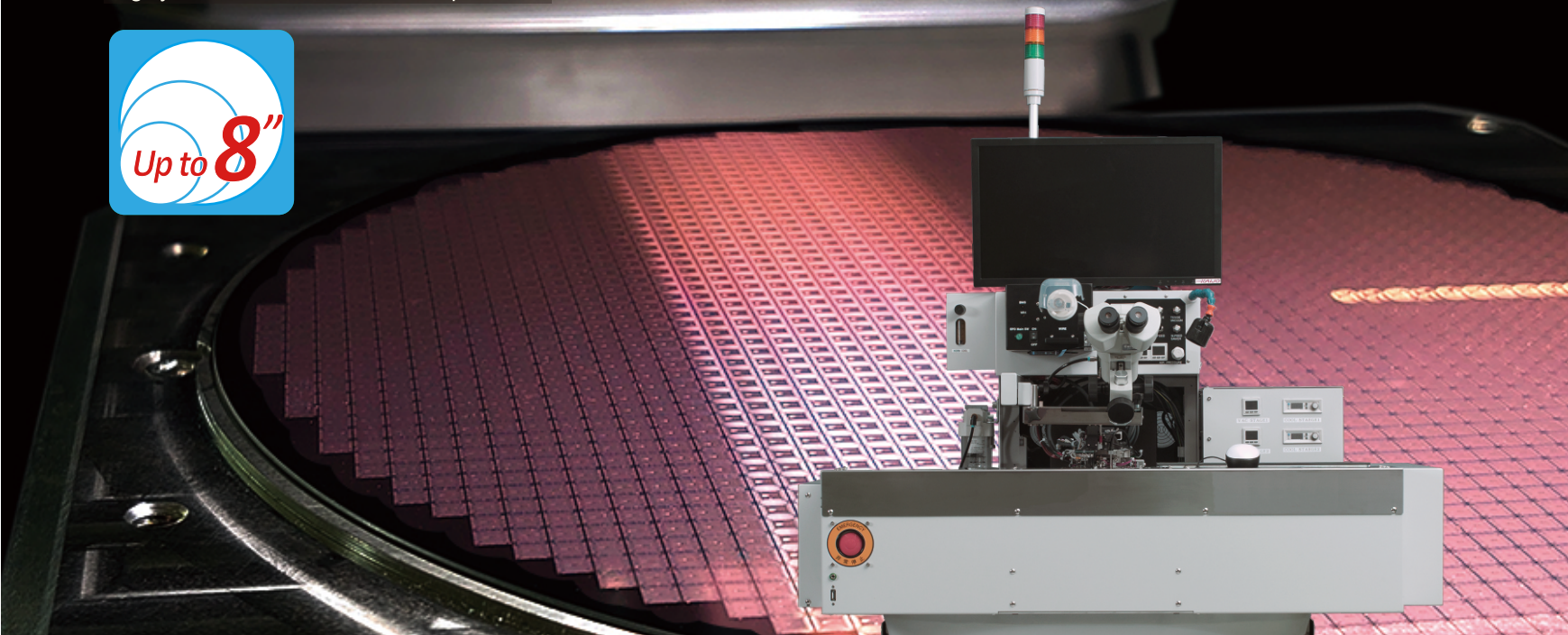


FB-x26 BUMP3

KAIJO

超声波兼用热压合（热超声键合）方式高精度植球机
Highly Accurate Thermosonic Bump Bonder



提高生产率的双平台结构
2 stage mechanism improves the productivity



特性 / FEATURES

- 通过双平台结构，消除了防止晶圆破损所需要的冷却时间，生产率大幅提升
2 stages eliminate cooling time required to prevent wafer damage - Productivity has greatly improved
- 提高可追溯功能和自我诊断功能，有助于品质管理和设备维护
Enhanced traceability and self-diagnosis function. Contribute to quality control and machine maintenance
- 满足不断提升的连接性和工业 4.0 的需求
SECS/GEM 作为标准配置，亦可使用 KAIJO 自有主机管理系统 KISS
Ready for the growing demand of connectivity and Industry4.0 - SECS/GEM or "KISS" (Selectable)
- 与晶圆供给装置 WHS-996 的组合，可实现自动搬送（另售装置）
Automatic wafer feeding is available in combination with a WHS-996 (Sold separately)



FB-x26 BUMP3

主要规格

焊线性能	
焊接方式	超声波热压焊接 (热超声) 方式
超声波振荡系统	由 PLL 输出频率自动跟踪振荡系统, 单频率
植球范围	200mm(8 英寸) 为止 (手动放置规格) 自动搬送规格为晶圆外围 2.5mm 在植球范围外 例) 8 英寸: 直径 195mm 的圆周为植球范围
重复位置精度	$3\sigma \leq 3.0\mu\text{m}^*$
植球速度	30msec/bump(Pull-Cut mode)** 40msec/bump(Fix-Cut mode)**
图像识别功能	
识别方式	可从形状识别方式 (α-eyes) 和多值化相关处理方式中选择
检测速度	约 100msec/2 点 (5mm 角芯片时) 约 200msec/4 点 (5mm 角芯片时)
检测率	99.9% 以上 **
对应工件	
晶圆尺寸	8 英寸 厚度: 0.2 ~ 0.5mm
外部通讯	
	SECS/GEM 标准搭载 KISS 标准搭载 (各主机软件另售或者另行咨询)
电气要求	
电源	单相 AC200V±5%, 50Hz/60Hz, 8A ※210V, 220V, 230V, 240V, 100V 可选择 最大消耗电力: 约 2.0kW
干燥压缩空气	压力: 0.3 ~ 0.970MPa (3 ~ 9.9Kgf/cm ²)、ISO5 级以上 消耗量: 40Liters/min 以下
真空	压力: -53.32MPa 以下 (400mm/Hg 以上)
尺寸·重量等规格	
尺寸	宽度: 1,132mm 深度: 1,234mm 高度: 1,728mm (包括信号灯 2,030mm)
重量	重量: 约 600kg

* 不包括自校准精度。

** KAIJO 规定条件下的计算值

*** Kaijo Interconnecting Service System 的缩写

SPECIFICATIONS

Bondability	
Bonding method	Ultrasonic with thermocompression bonding
Oscillation system	Frequency automatic tracking by PLL. Single frequency.
Bonding area	Up to 200mm (8 ") (Manual transfer specification) In case of automatic transfer specification, wafer circumference 2.5 mm become a non-bondable area. e.g. Bonding range of 8" wafer is diameter 195mm
Bonding Accuracy	$3\sigma \leq 3.0\mu\text{m}^*$
Bonding Time	30msec/bump(Pull-Cut mode)** 40msec/bump(Fix-Cut mode)**
Recognition System	
Recognition method	Shape recognition (α-eyes) or Multi-valued correlation processing (selectable)
Recognition time	Approx.100msec/2 points (5mm square chip) Approx.200msec/4 points (5mm square chip)
Detection rate	99.9% or more**
Applicable work size	
Wafer size	Up to 8" Thickness: 0.2 ~ 0.5mm
External interface	
	SECS / GEM available as standard KISS *** available as standard (Host software are option)
Utility	
Power	Single phase AC200V±5%, 50Hz/60Hz, 8A (210V, 220V, 230V, 240V, 100V option) Maximum power consumption: Approximately 2.0kW
Dry air	Pressure: 0.3 ~ 0.970MPa (3 ~ 9.9Kgf/cm ²) ISO class 5 or more Consumption: 40Liters/min or less
Vacuum	Pressure: -53.32MPa or less (400mm/Hg or more)
Dimensions	
Width	1,132mm
Depth	1,234mm
Height	1,728mm (To top of signal lamp: 2,030mm)
Weight	Approx. 600kg

* Excluding self-teach accuracy.

** Calculated value under the conditions specified by KAIJO.

*** Kaijo Interconnecting Service System



株式会社 カイジョー / KAIJO CORPORATION

東京都羽村市栄町 3-1-5 〒205-8607

3-1-5 Sakae, Hamura, Tokyo, JAPAN 2058607

URL <https://www.kaijo.co.jp>



深圳汉华半导体科技有限公司
Shenzhen Han Hwa Semiconductor Technology Co., Ltd

地址: 深圳市宝安区松岗街道潭头社区恒生工业园第四栋

电话: 0755-8524 0596 传真: 0755-2300 1062

邮箱: chenyp@hanhwachina.cn

网址: www.hanhwachina.cn



意见栏